Kiru Kezuru Migaku

Dry Polishing Wheels

DP08 SERIES

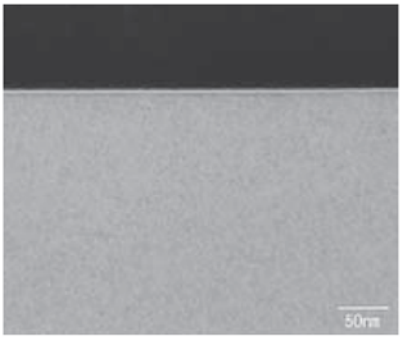
ケミカルフリーでストレスリリーフを実現するドライポリッシングホイール

通常プロセスのウェーハ研磨に加え、
DBGプロセスでも使用可能な
ケミカルフリーのストレスリリーフを実現

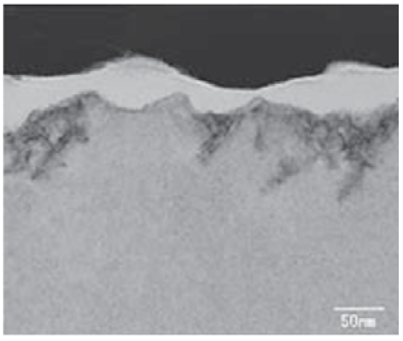
ディスコ独自のドライポリッシングプロセスで極薄ウェーハの研磨を可能にするDP08シリーズ。ケミカルフリーによって環境負荷が少ないだけでなく、スラリーを使用するプロセスに比べ容易なオペレーションで、高いチップ抗折強度を実現します。

■ダメージ比較（TEMによる観察）

ドライポリッシング後のウェーハでは、ダメージが除去されています。



DP08研磨後



#2000研削後

加工対象	シリコンウェーハ、他

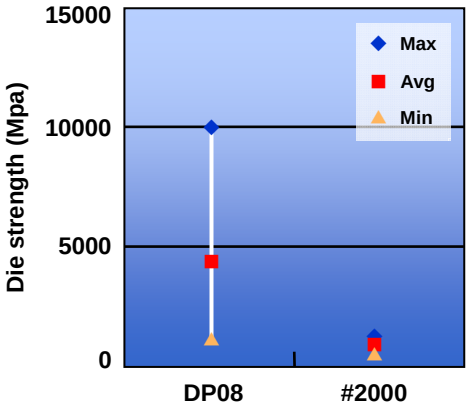
技術規格

DP08 － BC0101　450 × 11T × 150

品種　外径　厚さ　内径

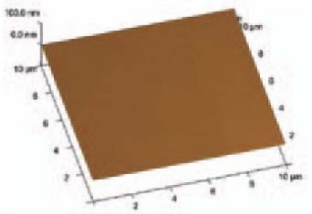
実験結果

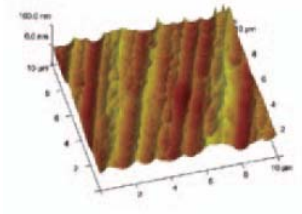
■抗折強度(球抗折)



ワーク　：ø8” Siウェーハ
最終仕上げ厚さ　：200 μm

■面粗さ





使用ホイール	DP08	Grinding wheel (#2000)
Ra (μm)	0.0003	0.0150
Ry (μm)	0.0017	0.0800

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・外径・厚さ・内径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当員が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。

・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますので、ご確認の上ご発注くださいますようお願い申し上げます。

⚠ 安全にご使用いただくために

ブレード、ホイール(以下、精密加工ツール)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- ●安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- ●制限回転数表示のある精密加工ツールは指定の回転数を超えて使用しないでください。
- ●精密加工ツールを装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- ●精密加工ツールを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ●使用する際には必ず毎回精密加工ツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ●ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ●改造された機械(装置)は使用しないでください。
- ●機械(装置)指定サイズに合わない精密加工ツールは使用しないでください。
- ●切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- ●湿式切断の精密加工ツールは冷却液をご使用ください。

DISCO CORPORATION
www.disco.co.jp

2014.11